

第4章

はんだ付けした部品のスムーズな交換に欠かせない

部品を取り外す技

4.1

ソケットや基板から多ピンのICを取り外す
DIP 部品を取り外す技

1

ICソケットに装着されたDIP 部品を取り外す

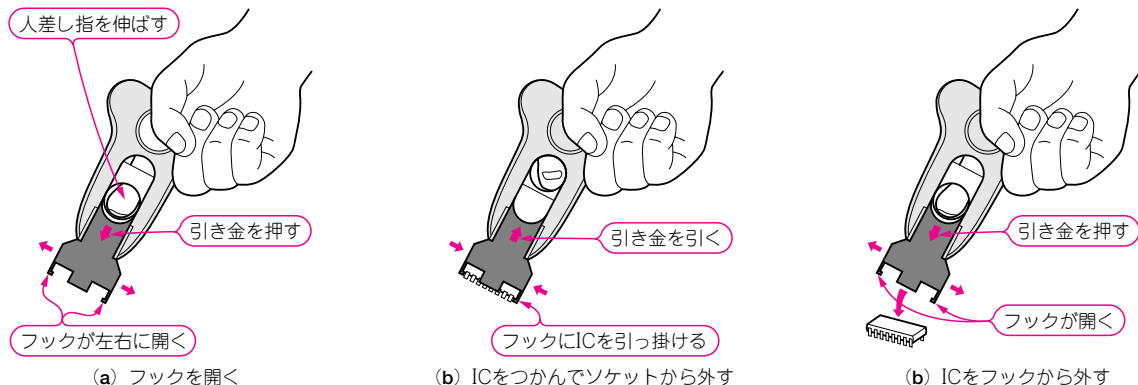
写真1 ICエクストラクタ



写真2 14ピンDIPを引き抜いているところ



図1 ICエクストラクタの使い方



ICソケットに装着されているDIP 部品は取り外しにくいものです。4ピン程度のICなら素手でも取り外せますが、14ピン以上ともなると難しくなりま

す。そこで「写真1」に示す「ICエクストラクタ」と呼ばれるICを引き抜く治具が市販されています。「写真2」に使っているようすを示します。ソケット

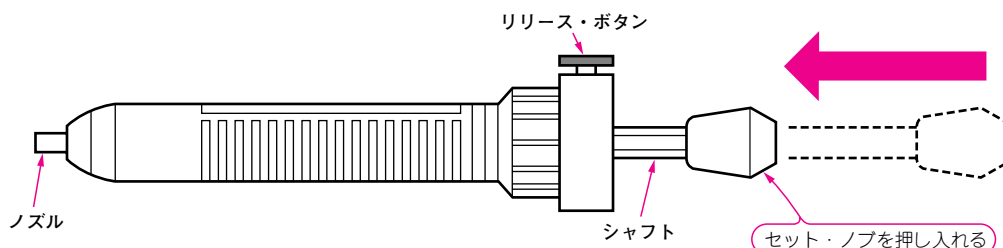
からICを片手で簡単に外せます。使い方を「図1」に示します。ICの幅やピン数によって数種類のモデルがあります。

〈島田 義人〉

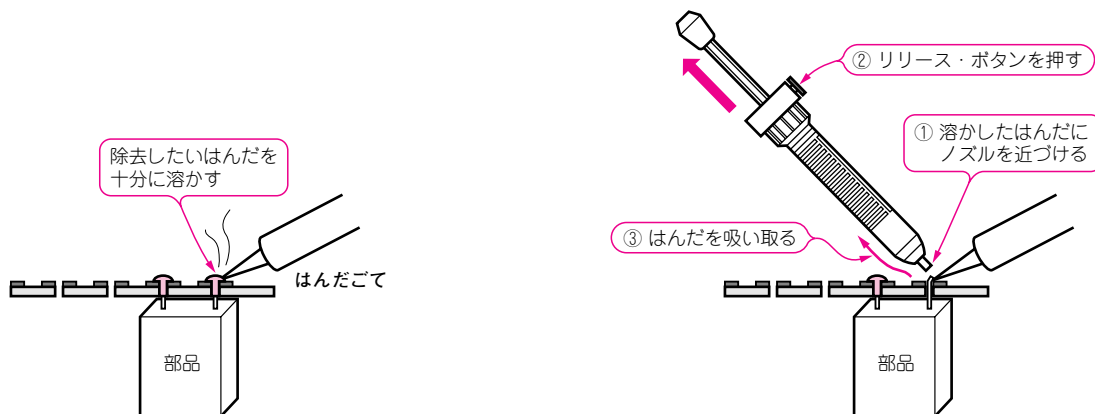
2

はんだ付けされたDIP部品を取り外す

図2 はんだ吸い取り器の使い方



(a) はんだ吸い取り器の準備



(b) はんだごてで加熱して除去したいはんだを溶かす

(c) はんだ吸い取り器ではんだを吸い取る

写真3 はんだ吸い取り器ではんだを除去しているところ

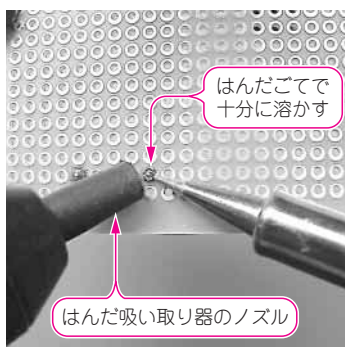
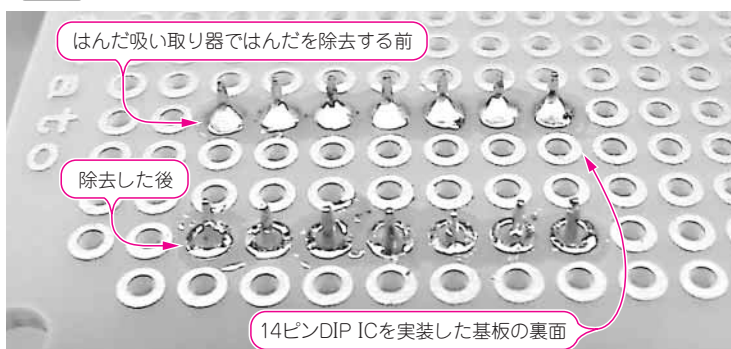


写真4 はんだ吸い取り器を使ってはんだを除去する前後の様子



DIP 部品の端子が直接はんだ付けされている場合、まずは、はんだ吸い取り器やはんだ吸い取り線を使って、端子やランドに付いているはんだを取り除きます(1-4節「はんだを吸い取る道具」参照)。

IC チップは熱に弱いため、溶かしたはんだを一瞬で吸い取れ

るはんだ吸い取り器のほうが適しています。

はんだ吸い取り器の使い方を図2 に示します。吸い込む直前まではんだごてを当てて、十分にはんだを溶かしておくことがポイントです(写真3)。

写真4 にはんだ吸い取り器ではんだを除去した前後の写真

を示します。状態を比較すると、フィレット(富士山形に付いたはんだ)がなくなっているのがわかります。

全ピンのはんだが除去できたら、DIP IC の場合は IC エキストラクタを使うと簡単に取り外せます。 <島田 義人>